



TIF® 100L 3040-06 是一款专为光学及高精密电子设备热管理需求而设计的超低硅氧挥发导热垫片。兼顾高效导热性能与极低可凝挥发物析出，有效避免对敏感光学元件及精密电路的污染。且该材料具备优异的柔软性与弹性，能够充分填充发热界面与散热结构之间的微观间隙，显著降低接触热阻，提升热传导效率，保障电子组件在长期运行中的可靠性与使用寿命。

特性

- 》超低硅氧烷挥发
- 》良好的热传导率
- 》耐候性与耐老化出色
- 》高可压缩性，易于安装操作
- 》良好的电气绝缘性能

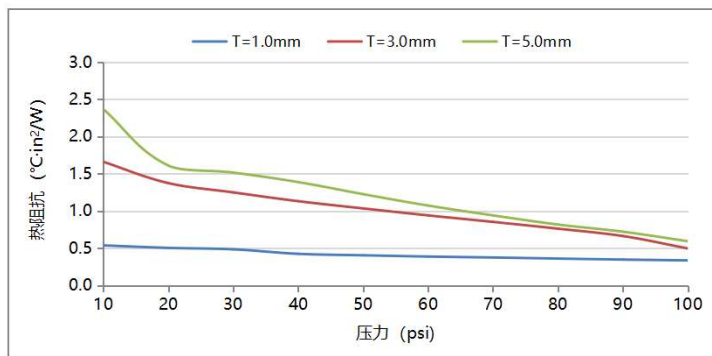
应用

- 》电机控制器 (MCU)
- 》机载计算机
- 》机器视觉摄像头
- 》高性能ASIC芯片
- 》中控屏

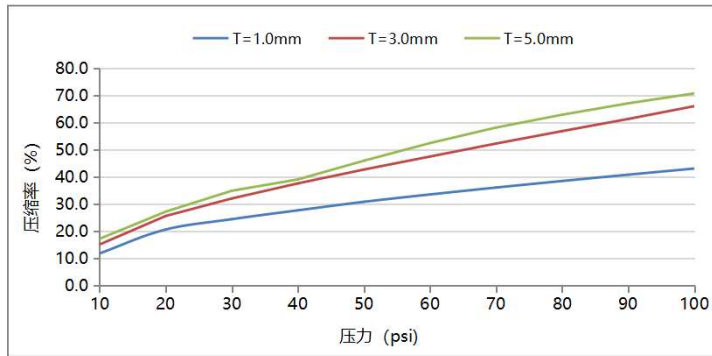
TIF® 100L 3040-06 系列特性表

产品特性	典型值		测试方法
颜色	白色		目测
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.010~0.020 0.25~0.50	0.030~0.200 0.75~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	65	40	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.0		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿电压 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
体积电阻率 (Ohm·cm)	> 1.0×10 ¹²		ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	3.0		ASTM D5470
	3.0		ISO22007
ΣD3-D10 (PPM)	< 100		GC-MS
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



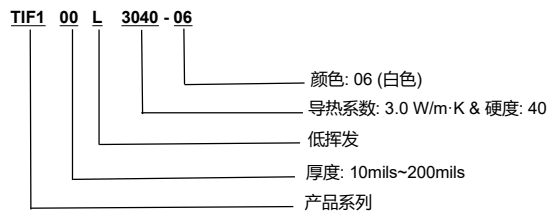
产品规格

标准厚度: 0.010" (0.25 mm) ~ 0.200" (5.00 mm), 以 0.010" (0.25 mm) 为增量。

标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

TIF®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系

产品型号说明



全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@zitek.com

www.zitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科技术有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF100L 3040-06-0126